

# 黄埔区 广州开发区新一代 信息技术产业发展实施细则

## 第一章 总则

**第一条** 根据《广州市黄埔区人民政府办公室 广州开发区管委会办公室关于加快IAB产业发展的实施意见》(穗开管办[2017]77号)(以下简称“本意见”),为便于本意见的实施,推进新一代信息技术产业发展,明确本意见中相关条款具体内容,结合本区实际,制定本实施细则。

**第二条** 本意见适用于工商注册地、税务征管关系及统计关系在黄埔区、广州开发区及其受托管理和下辖园区(以下简称“本区”)范围内,有健全财务制度、具有独立法人资格(或视同法人单位)、独立核算的新一代信息技术企业或机构。

**第三条** 本意见扶持的新一代信息技术产业领域包括新型显示、集成电路、新一代信息通信、基础硬件、物联网及车联网、云计算及大数据、互联网及软件服务、新一代信息技术服务业等行业。

**第四条** 企业或项目是否属于新一代信息技术产业范围,由奖励部门或奖励部门委托的第三方机构参照《广州市工业和信息化委 广州市统计局 广州市工商管理局 广州市国税局关于印发建立广州市新一代信息技术产业统计监测管理体系工作方案的通知》(穗工信[2018]3号)中《建立广州市新一代信息技术产业统计监测管理体系工作方案(试行)》和中华人民共和国国家标准 GB/T 4754—2017 综合认定。

**第五条** 集成电路企业及相关元器件在统计部门的国民经济行业分类(GB/T 4754—2017)代码为 3971、3972、3973、3974、3975、3976、3979、3981、3983、3984、3985、3989、6520。集成电路制造企业归为 3973,集成电路设计企业归为 6520。

**第六条** 申请本意见奖励资金的企业或非企业机构须提交承诺书,承诺书应当包含下列事项:  
(一)承诺对相关奖励条款及约定已知悉;  
(二)承诺领取奖励后 10 年内不迁离本区、不改变在本区的纳税义务、不减少注册资本、不变更统计关系、不得将企业核心业务和核心知识产权转移到区外。获得本意见奖励的企业如违反承诺,区相关主管部门应当追回企业领取的相关奖励资金。

## 第二章

## 支持重大产业项目集聚

**第七条** 对新建立的新一代信息技术重大产业项目,实际固定资产投资总额首次达到 1 亿元、5 亿元、10 亿元、20 亿元、30 亿元、50 亿元、100 亿元的,经认定,分别一次性给予 500 万元、1000 万元、2000 万元、3000 万元、5000 万元、8000 万元、2 亿元奖励。

(一)再次申请本奖励的企业,实际固定资产投资总额增加达到下一更高档次的,给予差额奖励,即公式为:当次奖励金额=当次符合档次的奖励金额-往次已获得的最高档次的奖励金额。奖励金额每家企业 5 年内累计最高不超过 2 亿元。

(二)已申请过本奖励的企业,如固定资产投资总额增加后仍未达到下一更高档次要求的,不予奖励。

(三)申请本奖励的企业应当符合以下条件:

1. 在本意见实施后在本区新建立的新一代信息技术重大产业项目,以工商营业执照登记日期为准;在本意见实施前已注册的企业,在意见实施后在本区新建的项目,以发改部门的立项备案登记日期为准;
2. 按照项目投资协议、备案及土地出让合同等文件约定时间完成竣工和投产;
3. 实际固定资产投资总额达到 1 亿元以上。

(四)符合奖励条件的企业应当提交以下材料:

1. 法定(授权)代表人签署的申请书、法定代表人的身份证明;
2. 营业执照、税务登记证(或“一照一码”营业执照);
3. 当年公司审计报告原件、纳税证明、年度纳税清缴报告原件;
4. 用地企业提供土地出让合同,非用地企业提供项目投资协议或项目备案文件;
5. 由具有资质的第三方出具的实际固定资产投资

6. 竣工验收证明等相关材料;
7. 投试产验收证明等相关材料;
8. 其他相关证明材料。

**第八条** 本章扶持的新一代信息技术重大产业项目,由区企业筹建主管部门负责认定及实质审核。

**第九条** 本章奖励事项特殊说明如下:

- (一)实际完成的固定资产投资额不含税计算,从新项目设立开始核算,以企业提供的具有资质的第三方出具的专项审计报告的数据为准。
- (二)实际固定资产投资额包含新建的土建工程、购置的新生产设备款,不包含购置土地、厂房、旧设备款和作为单位流动资金的投资等。
- (三)享受本奖励的项目,实际投产时间应在本意见有效期内。
- (四)区市场监管(工商)部门配合确定企业行业类别;区国土部门配合提供企业购买土地、房屋情况证明、土地交付情况;区建设部门配合提供建设工程竣工情况;区企业筹建主管部门提供企业项目试投产验收总体情况;区公安(消防)、建设、水务、环保、市场监管、安监等部门分别配合提供本部门负责的专项验收情况。
- (五)与区政府、管委会签订一事一议投资协议的项目按协议约定执行。

**第十条** 本章相关用语含义如下:

- (一)按约定完成基建工程竣工,是指从区政府、管

委会正式交地之日(区土储或土地平整主管部门发放《筹建企业地块交付签收表》)起计算,至取得《建设工程竣工前质量检查情况通知书》之日止,建设时间在《国有建设用地使用权出让合同》约定的竣工时间内的(企业在建设过程中,因政府原因导致工期延误的,时间予以相应扣除)。

(二)投试产验收,是指重大产业项目完成建设工程竣工消防验收、基建竣工验收备案、企业厂区道路排水排污设施验收备案、建设项目竣工环保验收、建设项目安全生产设施竣工验收备案等专项验收后,由区企业筹建主管部门发放《投试产验收情况告知函》。

(三)实际投产时间,是指企业项目自国有建设用地使用权出让合同约定的土地交付之日起计算(如地块需要政府进行平整和管线迁移的,按照区土储或土地平整主管部门发放《筹建企业地块交付签收表》之日起计算),至完成相关验收取得《投试产验收情况告知函》之日止实际所用的时间。

(四)约定投产时间,是指企业项目签订国有建设用地使用权出让合同所约定的投产起止时间。对于国有建设用地使用权出让合同约定 2 年内投产运营但没有规定具体投产日期的,认定日期为企业项目自国有建设用地使用权出让合同约定的土地交付之日起(如地块需要政府进行平整和管线迁移的,按照区土储或土地平整主管部门发放《筹建企业地块交付签收表》之日起计算)届满 2 年的日期。

(五)在约定时间内投产,是指企业项目实际投产时间少于或等于国有建设用地使用权出让合同约定的投产时间。

## 第三章

## 扶持集成电路产业发展

### 第一节 注册资本奖励

**第十一条** 对新设立的集成电路设计或封测企业(主营业务为集成电路设计或封测),实缴注册资本 2000 万元以上的(外资企业注册资本折算为人民币核算),经认定,按其实缴注册资本的 5% 给予奖励,最高奖励 300 万元。

(一)申请本奖励的集成电路设计或封测企业应当符合在本意见实施后在本区新注册设立且正常经营的条件,具体以工商营业执照登记的日期为准。

(二)符合奖励条件的企业应当提交以下材料:

1. 法定(授权)代表人签署的申请书、法定代表人的身份证明;
2. 投资协议或经济效益承诺书;
3. 营业执照、税务登记证(或“一照一码”营业执照);
4. 用地企业需提交土地出让合同及缴款土地出让金证明;
5. 非用地企业需提供经营场地证明,财务审计报告或者年度纳税清单;
6. 其他相关证明材料。

**第十二条** 本节所扶持的新设立的集成电路设计或封测企业,由区招商主管部门负责认定及实质审核。

**第十三条** 本节所涉及的注册资本,应当由具有资质的第三方机构出具专项验资报告,实缴注册资本专指货币出资,不包括其他方式出资。本节所称设立,以企业工商注册登记时间为准。企业设立和实缴注册资本时间均应当在本意见有效期内。

**第十四条** 企业在本意见有效期内达到奖励条件的,即可享受本奖励。申请本节奖励的企业,须在达到扶持条件的当年度或次年度 10 月 31 日前提出申请,逾期不申请视同自动放弃相关权利。

**第十五条** 本节奖励事项特殊说明如下:

- (一)对于本意见实施前区内原有的集成电路设计或封测企业,在本意见实施后,增加实缴注册资本 2000

万元以上的(外资企业注册资本折算为人民币核算),参照本节规定按新注册企业给予一次性奖励。

(二)本意见实施后起从区外迁入的实缴注册资本 2000 万元以上的企业,在本意见有效期内在本区主营业务收入相比迁入前正增长的,按本实施细则的认定流程参照新注册企业给予一次性奖励。新增主营业务收入均以企业迁入前 1 年在迁入区对应数据为基数。

(三)区内企业与区外企业合并,通过收购、并购、重大资产重组等形式新成立的企业,按注册资本的净增量参照新注册企业予以奖励。

(四)同一集团公司及关联公司在本区设立多家公司的,不超过 3 家(含集团公司本身)享受本奖励。同一集团公司及关联公司间存在相互投资的形式提高注册资本金情形的,原则上仅 1 家公司(含集团公司本身)可享受本奖励。企业需提交集团公司组织架构说明文件。

### 第二节 主营业务收入奖励

**第十六条** 对当年主营业务收入达到 1 亿元、3 亿元、5 亿元、10 亿元的集成电路设计或封测企业,首次申请本奖励,经认定,分别一次性给予 2000 万元、2500 万元、3000 万元、5000 万元奖励。

(一)再次申请本奖励的企业,企业当年集成电路设计或封测业务的营业收入同比上一次申请奖励时达到下一更高档次的,给予差额奖励,即公式为:当年奖励金额=当年符合档次的奖励金额-往年已获得的最高档次的奖励金额。奖励金额每家企业 5 年内累计最高不超过 5000 万元。

(二)已申请过本奖励的企业,如下一申请年度营业收入未达到下一更高档次要求的,不予奖励。

(三)申请本奖励的企业当年集成电路设计业务或封测业务营收应当达到 1 亿元以上。

(四)同一集团公司及关联公司在本区设立多家公司的,不超过 3 家(含集团公司本身)享受本奖励。

(五)符合奖励条件的企业应当提交以下材料:

1. 法定(授权)代表人签署的申请书、法定代表人的

- 身份证明;
2. 营业执照、税务登记证(或“一照一码”营业执照);
3. 当年公司审计报告原件、纳税证明、年度纳税清缴报告原件;
4. 集成电路设计或封测业务营业收入的专项审计报告原件;
5. 其他相关证明材料。

**第十七条** 本节扶持的集成电路设计或封测企业,由区工信部门负责认定及实质审核。

### 第三节 项目研发补贴

**第十八条** 企业研发多项目晶圆(MPW)流片的,按直接费用的 80% 给予补贴;企业购买光罩、研发全掩膜(Full MASK)流片的,按直接费用的 40% 给予补贴;企业研发工程片、试流片的,按加工费用的 30% 给予补贴,同一企业每年合计最高补贴 600 万元。

(一)符合扶持条件的企业应当提交以下材料:

1. 申请表;
2. 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证(已实行三证合一的,提供企业营业执照;如属于非企业机构,参照提供);
3. 研发费用专项审计报告;
4. 研发多项目晶圆、购买光罩、研发工程片或试流片直接费用明细及发票等材料;
5. 申报公告中所要求的其他材料。

**第十九条** 申请项目研发补贴的企业,由区科技主管部门负责认定及实质审核。

**第二十条** 本节扶持事项特殊说明如下:

- (一)申请项目研发补贴的企业,应当设立研发项目的财务辅助账,申请上级和本级财政资助总额不能超过企业项目自筹资金总额,超过部分不予支持。
- (二)同一法人代表企业、隶属于同一集团企业、关联企业、控股企业、母子公司等相关企业之间互相采购产品不纳入补贴范围。

